

通信基础设施

整机动向

- 高速通信 (~40Gbps)
- 端口、数据数增加
- 薄型化 (1U)

电源动向

- LSI负荷电流的增加

LSI大电流化&LSI数量增加
<输出>

- FPGA/ASIC (1V/~70A)
- 其他LSI (1V/~20A)

电容器
要求规格

低ESR

大容量

低外形

推荐商品特长

SP-Cap

- 超低ESR (3mΩ~)
- 低外形 (1~2mm)

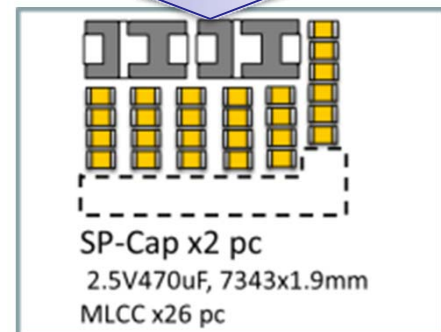
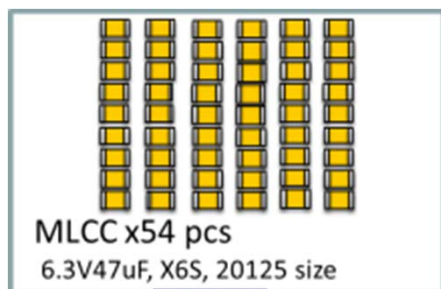


POSCAP

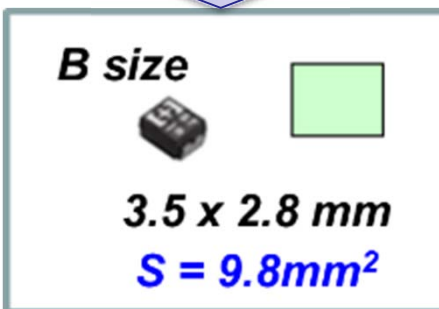
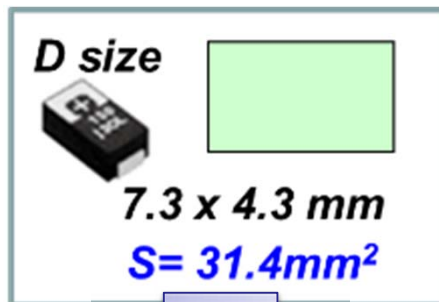
- 低ESR (5mΩ~)
- 小型化 (3528)



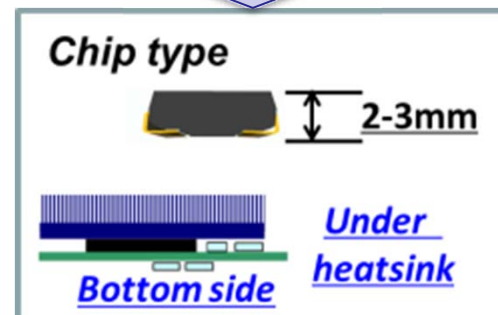
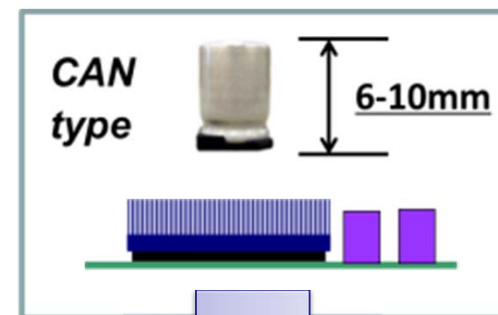
提案



➤ 成本削减+空间削减



➤ 成本削减+空间削减



➤ 空间削减